半导体温度计的设计和制作

王启骅 PB20020580

2022年3月8日

0.1 实验目的

用半导体热敏电阻作为温度传感器,设计制作一个半导体温度计,温度测量范围: 20 70°C。设计制作相应的测温电路,实现测量要求。

0.2 实验原理

半导体电阻值随温度变化关系: $R_T = R_{\infty} e^{\frac{P}{T}}$

电阻随温度升高而急剧降低,通过测量其阻值来确定温度。 热敏电阻伏安曲线的起始部分接近线性,电流的影响可以忽略不计,热敏电 阻的阻值主要与外界温度有关,在温度计设计制作过程中要使热敏电阻工作 在其小电流的线性区。

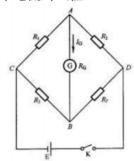


图 16-3 热敏电阻测温电路原理图

在温度下限 T_1 时,微安计 $I_g=0$ 此时热敏电阻值为 R_{T_1} ,电桥处于平衡状态,满足平衡条件 $\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_3}{R_{T_1}}$ 。取 R1=R2,则 R3=RT1。由此确定了 R3 的电阻值即为热敏电阻处在测温量程的下限温度时的电阻值 RT1。当温度增加时,热敏电阻的电阻值就会减小,电桥失去平衡,通过电路分析可以根据微安计的读数 IG 的大小计算出 RT,从而得到 I_G 与温度的关系。当达到上限温度 T_2 时,微安计满偏,可得 $V_{CD}=I_T(R_3+R)$

曲基尔霍夫方程:
$$I_G = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_{T2}}{R_3 + R_{T2}}}{R_G + \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3R_{T2}}{R_3 + R_{T2}}}$$
 带人 $R_1 = R_2, R_{T1} = R_3$ 得:
$$R_1 = \frac{2V_{CD}}{I_G} (1/2 - \frac{R_{T2}}{R_{T1} + R_{T2}}) - 2(R_G + \frac{R_{T1}R_{T2}}{R_{T1} + R_{T2}})$$

选取 $V_{CD} = 1V$,保证热敏电阻工作于其伏安特性曲线的线性部分

0.3 实验仪器

实验仪器:烙铁、万用表、恒温水浴箱2个。电路元件:热敏电阻(温度特性给定)、微安计(内阻Rg已知)、可变电阻箱、电位器5个、1.5V电池、多档开关、待焊接的电路板、导线若干。

0.4 实验数据

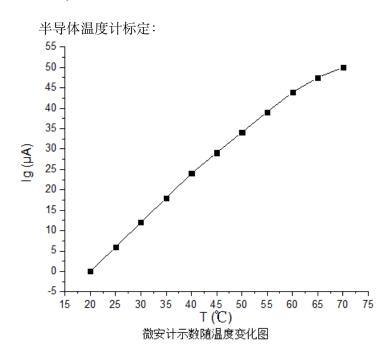
T/°C	20	25	30	35	40	45
R/Ω	2332	1971	1675	1403	1183	1006
Ig/µA	0.0	6. 0	12.0	18.0	24.0	29. 1
T/°C	50	55	60	65	70	
R/Ω	854	718	608	522	450	
Ig/µA	34. 1	39. 1	43. 9	47. 5	50.0	

表 1: 半导体温度计标定原始数据表

水银温度计读数/℃	31. 9	58. 9
Ig/μA	14. 1	42.1
测量温度/℃	31. 75	58. 12

表 2: 温度计测试数据表

0.5 数据处理与误差分析



温度计测试:
$$\frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{31.9 - 31.75}{31.9} = 0.5\% \qquad \frac{\Delta T_2}{T_2} = \frac{58.9 - 58.12}{58.9} = 1.3\%$$

0.6 实验讨论

焊接好电路后要及时检查是否虚焊,以免实验时带来不便。调节好 R_1, R_2, R_3, R_4, R 后,应注意不要碰到调节旋钮,以免其电阻改变。

0.7 思考题

1. 由于万用表测量的实际上是电阻与导线串联的总电阻,所以比实际电阻略大。2. 要使电路断路,防止测量得到的结果与实际电阻大小有偏差,并且防止在测量电阻时流过微安计电流过大,损坏电表。3. 调节 R 可调节电桥部分的分压,通过改变该部分的分压可改变流过微安计的电流大小,使电表满偏。4. 可在之后的使用温度计过程中用 2 档测试温度计是否正常工作,若仍微安计满偏,则说明温度计正常,否则需要重新校准。